



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SIMM 插槽



模块方向: 直角

位数: 72

工作温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到

印刷电路板

结构特性

钥匙数

1

行数

1

模块方向

直角

位数

72

主体特性

插销材料

黄铜

固定柱位置

中心

插销电镀材料

镍

连接器外形

标准

接触件特性

内存插槽类型

内存卡

端子接触部电镀材料

锡

端子底板材料

镍

PCB 端子端接区域电镀材料

锡

端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

插入种类	凸轮
端接柱体和尾部长度	3.05 mm[.12 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

极化	左
接合对准类型	中心柱
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	LCP（液晶聚合物）
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

中心固定孔直径	2.45 mm[.096 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	24
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MICRO-EDGE SIMM



SIMM 插槽(3)

客户还购买了



TE 产品编号1609112-2
10CBS1=F7889 M0



TE 产品编号5747840-4
HD-20 PLUG RA .318 FMS BD-LK 4



TE 产品编号4-1622820-0
3520 33R 5%



TE 产品编号2-1445057-2
MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW



文档

产品图纸

[SIMM II, .250" H, .050CL, 72P, SN](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-5382486-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-5382486-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-5382486-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。